									Shee	et 1/	
製品規格 / Product Specification 品種名 / Type Number: ON 2 2 7 0 - (LF) 松下統一品番 / Matsushita Unified Parts Number : CN B 2 3 0 1 0 0 LF *1				Prepared by		ecked by	by		Established by		
種別 / Type	 反射型フォトセンサ / Photo Reflect			Reflecto	A.Nakano	I.Na	kagawa	S.Nakagav	/a		
用途 / Application					Detection、	Contactle	ss SW				
構造 / Structure	G a A s 赤	外発光ダ	イオード(非干涉性	E)・Siダ - リ Non-Interfe	ントンフォ	トトランジス		Transiat	or	
接続 / Connection 外形 / Outline		Attached			Non-Interre	rence) nr	IN SI Dali			01	
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings	V _R 3 V	I _F 50 mA	P _D 75 mW	I _c 30 mA	V _{CEO} 20 V	V _{ECO} 5 V	P _c 75 mW	Topr -25 ~ +8		Гstg) ~ +100	
re E	電気的·光	学的特性	/ Electri	cal-Optic	cal Characte	eristics (Ta=25	±3)			
項目 / Item		略号 Symbol	測定	条件 / M	easuring Co	ndition	Тур.	Liı Min.	mit Max.	Unit	
入力特性 / Electrical C	haracteri	stics - Inp	ut Diode					·		•	
順電圧/Forward Voltag	е	$V_{\rm F}$	I _F =50 m	A			1.3	-	1.5	V	
逆電流/Reverse Currer	nt	I _R	V _R =3 V				0.01	-	10	μA	
端子間容量/Capacitance Ct		Ct	V _R =0 V, f=1 MHz			30	-	-	- pF		
出力特性 / Electrical C	haracteri	stics - Ou	tput Tran	sistor			1	1	1	I	
コレクタ遮断電流/Collector to Emitter Dark Current			V _{CE} =10 V			-	-	1.0	μA		
伝達特性 / Electrical C	haracteri	stics Co	upled								
コレクタ出力電流/ Collector Current		Ι _c	V _{cc} =5 \ d=1 mm		A, R _L =100 (注 1) [。]	, (Note1)	-	0.46 (注 2)(12.0 Note2)	mA	
暗電流/Dark Current		Ι _D	V _{CC} =5 \	/, I _F =2 m/	, I _F =2 mA, R _L =100			-	2.0	μA	
応答時間/Switching Tir	ne	tr,tf	V _{CC} =10	V, I _c =1 n	nA, R _L =100		150	-	-	μs	
コレクタ・エミッタ飽和電圧/ Collector-Emitter Satur Voltage	ation	V _{CE} (sat)	I _F =5 mA	A, I _C =0.5 r	nA		-	-	1.5	V	
(注 1)(Note1)出力電流涨 d d l _F ↓		'Output Cu	V _{cc}					n Evaporatior lass Board(d=			
1994-12-08		2004-11-0)5								

製品規格 / Product Specification 品種名 / Type Number: ON2270 - (LF)	
松下統一品番 / Matsushita Unified Parts Number	
: C N B 2 3 0 1 0 0 L F	
*1	

(注 2)(Note2)I_c ランク分類 / I_c Rank classification

*1 Code=ランク/Rank	lc(mA)	色表示 Rank Color	品番 Type Number	松下統一品番 Matsushita Unified Parts Number		
Q	0.46 ~ 1.75	桃/Pink	ON2270-Q(LF)	CNB23010Q0LF		
R	1.30 ~ 4.95	黒/Black	ON2270-R(LF)	CNB23010R0LF		
S	3.15 ~ 12.0	青/Blue	ON2270-S(LF)	CNB23010S0LF		

(注 3)(Note3)入出力は電気によって行われます/Input and output are practiced by electricity.

(注 4) 本製品は、耐放射線を考慮した設計ではありません

(Note4) This device is designed by disregarding for radiation.

1994-12-08	2004-11-05	
Established	Revised	
		Semiconductor Company, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Sheet 2/7



Semiconductor Company, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

製品規格 / Product Specification 取扱い上の注意事項 / Caution For Handling 品種名 / Type Number: ON 2 2 7 0 - (LF) 松下統一品番 / Matsushita Unified Parts Number : CN B 2 3 0 1 0 0 L F

樹脂モールドタイプの光素子は、発光や受光の効率をあげる為、フィラーの添加をおさえた純度の高い樹脂にて モールドされています。

このことよりIC、LSIなどの樹脂と異なり、熱的・機械的ストレスや薬品などの取扱いによって素子の信頼性が 大きく左右されます。 従いまして、以下の点にご留意頂き、ご使用願います。

Photo-element of resin mold has been treated with molding with height pure resin by suppressing the addition of filler in order to elevate the efficiency of light emitting and light receiving functions. Accordingly, unlike the resins such as IC and LSI, the reliability of element will be greatly influenced by the handling of chemicals, thermal or mechanical stress. Therefore, please note the followings;

[はんだ付け] / [Soldering]

はんだ付け位置 / Soldering position.

A:1.6 mm 以上の距離を確保下さい。

A:Keep away Min.1.6 mm from the package.



はんだ付け温度、時間 / Soldering Temp/Time

・はんだ温度 / Iron Soldering temp ;260 以下 / Less than 260

·時 間/Soldering time ;5 秒以内/Less than 5 s

·回 数/Soldering Repeat ;1回/Less than 1 time

リフローはんだ方式及びそれに類する方式(フロ - はんだも含む)でのはんだ付けは、避けて下さい。 Avoid soldering in the reflow solder method and the method (including flow solder, too) which does a kind to it.

フラックス成分 / Flux an ingredient

塩素系成分を含有しないものを推奨しますが、ご使用の際は実質上問題が無いことを充分確認下さい。 Please don't be used flux in chlorine an ingredient.

They should be Applied after testing the assembled product in real use.

[リ-ド成形・切断] / [Lead bent/cut]

・高温の状態でのリ-ド成形・切断を行いますと断線事故の原因となりますのでリ-ド成形・切断は常温で行い、加えて過度の機械的ストレスが加わらないように行って下さい。特にはんだ付け直後は、温度が高くなっていますのでご注意下さい。

• The lead should be bent/cut at a normal temperature and not be exposed to excessive mechanical stress(If the lead is bend/cut at a high temperature. it may cause on open circuit or other problems.) Please be especially careful after soldering.

[洗浄方法] / [Cleaning]

·洗浄溶剤については、アルコ - ル系を推奨致します。

尚、塩素系溶剤は、リ・ドを腐食したり、素子の劣化の原因となりますので使用しないで下さい。 ·Alcohol are recommended for cleaning.

Or a chlorine solvent which may cause damage to the epoxy and chip die.

- ・超音波洗浄は、素子の構造及び材質上よりお避け下さい。
- ·Please don't be cleaned by ultrasonic cleaning.

1994-12-08	2004-11-05
Established	Revised

Semiconductor Company, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

製品規格 / Product Spec 取扱い上の注意事項 / Ca 品種名 / Type Number: O 松下統一品番 / Matsushi :(aution For Handling N 2 2 7 0 - (LF)	
「製品保管・使用期网]/[Product storage •	Use term1
・本製品は、リフロ・ジ 樹脂は吸湿します。 清浄な場所で、温度 また、使用期限につ ・Epoxy resin inhales because this produ are stored in norm dust and corrosive	対象商品ではありませんの 従いまして、常温・常湿中 と・湿度変化の少ない所に いては、1年以内にご使月 humidity fundamentally, ct is not reflow object n al temperature and norm	つで、特別な防湿管理は必要ありませんが、基本的にエポキシ に保管することが望ましく、塵埃、腐食性ガスの発生しない 保管して下さい。 引される事を推奨致します。 although special dampproof control is not necessary, nerchandise. Accordingly, It is recommended that the device al humidity, the storage location should be clean, free from tle fluctuation in temperature and humidity.
[その他] / [Other]		
	ュ - ト、アンダ - シュ - ト電	『圧等の異常電圧が加わらないようご配慮下さい。
 ・本資料に記載されて 製品など)に使用さい 作が直接人命を脅い 燃焼機器,安全装置 えのお客様は、事前 ・This device is designed Communication equality If this device is rearrelation、Traffic equality 	おります製品は、標準用語 れていることを意図してお かしたり、人体に危害を及 置など)にご使用をお考え (に弊社営業窓口にご相話 gned for normal uses; Ge uipment、Instrumentation quired specific reliability uipment's、Combustion ed	tage, over shoot voltage, under shoot voltage, etc.) 途; 一般的電子機器(事務機器,通信機器,計測機器,家電)ます。特別な品質,信頼性が要求され、その故障や誤動 ぼす恐れのある用途;特定用途(航空,宇宙,交通機器, のお客様及び、弊社が意図した標準用途以外でご使用をお考 炎願います。 neral electronic equipment's (Office equipment、 equipment、Home electrification product etc). 、and is used for specific uses(Flying·Space quipment's、Safety equipment's etc) where fault of Id ask to Matsushita Electronics Corporation.
長期保管が予	則される場合は、リード表	きでありますので、開封後は速やかにご使用下さい。 面の変色が発生しますので必ず常温常湿雰囲気に近い
環境にて保管 ⁻ (Note)Please be ca	トさい。 reful that the lead is no	t oxidized.
*保管条件 / S	torage condition	
温度:5 ~	- 35 湿度:45 %~75 %	/ Ta=5 ~ 35 、RH=45 % ~ 75 %
1994-12-08	2004-11-05	
Established	Revised	

					S	heet
品規格/Product Specification 頓性保証基準/Reliability Guarantee Crite 障判定基準/Failure Criterion 種名/Type Number:ON2270 - (LF) 下統一品番/Matsushita Unified Parts Nur :CNB23010 0LF *1						
i頼性保証基準は、(MIL-STD-19500H LTP eliability Guarantee Criterion(MIL-STD-19						
項 目 / Item			件 / Test Conditions		結果/	Result
実用動作試験 / Operating Test	Ta=65	,I _F =23 mA,	Vcc=10 V, t=1 000 h			/15
高温高湿保存試験 / High Temperature Humidity Storage Life Test	Ta=60	,RH=90 %,t	=1 000 h		0/15	
高温保存試験 / High Temperature Storage Life Test	Ta=100	,t=1 000	h		0/	/15
低温保存試験 / Low Temperature Storage Life Test	Ta=-30	,			0/15	
熱衝擊試験 / Thermal Shock Test	0 ~ -30 5 min) (5 r	nin)		0/15		
温度サイクル試験 / Temperature Cycle Test	(30	Ta = 100 ~ 25 ~ -30 (30 min) (5 min) (30 r		Cycle	07	/15
はんだ耐熱試験 / Soldering Heat Resistance Test	パッケーシ	度:270 ,10 秒, [•] 底面より 2.0 mm 迄,フラックスなし 270 ,t=10 s,Min:2.0mm from the Package			0/15	
はんだ付け性試験 / Solderability Test	試験温』	前処理:Ta=85 ,RH=85 %,t=16 h 試験温度:230 ,5 秒,フラックスあり Solder :230 ,t=5 s with flux			07	/15
落下試験 / Drop Test	式験 / Drop Test Distance		m より厚さ 3 cm 以上の楓板上自然落下 3 回 ce of dropping : 1 m ne device on the maple board 3 times			/15
リ - ド線引張り試験 / 静荷重		5 N,30 秒間 due to the terminal:5 N,t=30 s			0/15	
リ-ド線折曲げ試験 / 静荷重 Ferminal Bend Test		2.5 N,90 度折曲げ,2 回 due to the terminal:2.5 N, Bend the al at right 90 angle to back, 2 times			0/15	
如障判定基準 / Failure Criterion					_	
項 目/Item		記 号 判定基準(注)/Criterion(Note		1	単位	
項 日/11600		Symbol	下限/Lower Limit	上限/Upper L	₋imit	Unit
電気	気的特性 /	Electrical C	haracteristic		,	
コレクタ出力電流変化率 / Collector Current		Ι _c	50	150		%
暗電流 / Collector to Emitter Dark Current		I _{CEO}	-	U × 2.0		nA
順方向電圧 / Forward Voltage		V _F	-	U × 1.2		V
	外観,作	他 / Appeara	nce, etc			
外 観 / Appearance		外形規格に準ずる / According to visual spec				
錆·変色 / Rusting, Discoloring			- ド部)なきこと / No r		ing (Le	ad)
はんだ付性 / Solderability		浸漬部分に 95 %以上はんだが付く事 The Solder must stick to steeped part more than 95 % of				

the face area. (注)(Note) U:初期規格上限值 / Upper initial standard

1994-12-08	2004-11-05	
Established	Revised	

はんだ付性 / Solderability

Semiconductor Company, Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.

The Solder must stick to steeped part more than 95 % of

